

題號： 177

國立臺灣大學 107 學年度碩士班招生考試試題

科目： 牙科材料學

題號：177

節次： 4

共 1 頁之第 1 頁

1. 請問牙科材料以高分子聚合的反應機制有哪些材料？亦請描述其反應機制。(20 分)
2. 影響牙科複合樹脂拋光的機制有哪些？亦請描述如何影響。(20 分)
3. 請說明牙科 self-etch bonding system 與 etch-and-rinse bonding system 的作用機制與臨床操作技巧。
(20 分)
4. 請問牙科目前常用的陶瓷有哪幾種？其主要成分為何？其各自所需的厚度需要達到多少才能提供人類咬合力與自然磨損所需求？(20 分)
5. 牙科用鑄造金屬(dental alloys)常分為四類 Type I (soft), Type II (medium), Type III (hard), Type IV (extra-hard)，此四種合金主要運用在哪些補綴物呢？(20 分)

試題隨卷繳回